

特集2

リンクする PCB&LSI設計フロー



電子機器を開発する場合、プリント基板設計とLSI設計は独立して進められることが多い。しかし、両者のフローを包括的に考えないと対処できないトラブルが今後は増えてくる。例えば、LSIのピン数が数百を超え、回路図シンボルの作成に大きな手間がかかるようになってきた。また、FPGAやComplex PLDのように、設計の途中でピン割り当てが変更されるようなデバイスも存在する。ここでは、こうした問題を考慮しながら、プリント基板とLSIを同時に開発するための最適な設計フローを検討する。

C O N T E N T S

- 第1章 FPGAの設計フローをボード・レベルの視点で見直す
ピン情報の流用とボード・レベル・シミュレーション
- 第2章 二つの設計フローをつなぐ「シンボル作成ツール」
ピン割り当ての変更に伴う影響をきちんと管理
- 第3章 デジタル・ボード設計から回路図が消える!?
Innoveda社が提唱するHDL2PCBのコンセプト